(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
19. April 2012 (19.04.2012)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2012/049058 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01L 21/67 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2011/067405

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. Oktober 2011 (05.10.2011)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2010 048 043.6
15. Oktober 2010 (15.10.2010) DE

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **EV GROUP GMBH** [AT/AT]; 1, DI Erich Thallner Straße, A-4782 St. Florian am Inn (AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **LINDNER, Paul** [AT/AT]; 56, Max Hirschenauerstraße, A-4780 Schärding (AT). **HANGWEIER, Peter-Oliver** [AT/AT]; 25, Hofmark, A-4742 Pram (AT).

(74) Anwälte: **SCHWEIGER, Johannes** et al.; 22, Turmstraße, 40878 Ratingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

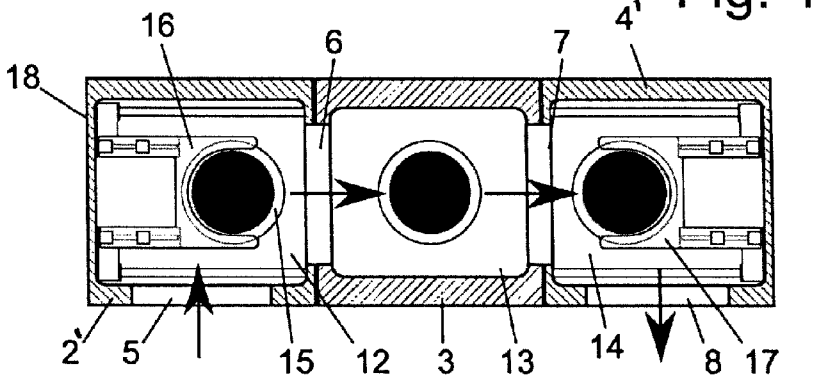
Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*

(54) **Title**: DEVICE AND METHOD FOR PROCESSING WAFERS

(54) **Bezeichnung** : VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR PROZESSIERUNG VON WAFERN

Fig. 4



(57) **Abstract**: The invention relates to a device for processing substrates, in particular wafers (15), comprising at least one pre-treatment module (9), at least one post-treatment module (11) and at least one main treatment module (10), wherein the pre-treatment module (9) and the post-treatment module (11) can be switched as transfer channels for the main treatment module (10), and to a corresponding method for processing substrates, in particular wafers.

(57) **Zusammenfassung**: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Prozessierung von Substraten, insbesondere Wafern (15), mit mindestens einem Vorbehandlungsmodul (9), mindestens einem Nachbehandlungsmodul (11) und mindestens einem Hauptbehandlungsmodul (10), wobei das Vorbehandlungsmodul (9) und das Nachbehandlungsmodul (11) als Schleuse für das Hauptbehandlungsmodul (10) schaltbar sind, sowie ein korrespondierendes Verfahren zur Prozessierung von Substraten, insbesondere Wafern.

WO 2012/049058 A1